# Особливості формування шарів пористого кремнію модифікованих HCl і HBr в контексті оптичних властивостей

# Є.І. Зубко<sup>\*</sup>

Запорізька державна інженерна академія, вул. Добролюбова, 22, Запоріжжя 69000, Україна

(Одержано 23.11.2011, у відредагованій формі – 20.05.2012, опубліковано online 04.06.2012)

Досліджено спектри пропускання, відбиття та коефіцієнт заломлення шарів поруватого кремнію, виготовленого в розчинах HF(48 %):HCl:H<sub>2</sub>O і HF(48 %):HBr:H<sub>2</sub>O за умов освітлення зразка і без нього. Встановлено, що шари виготовлені в розчині HF(48 %):HBr:H<sub>2</sub>O = 16 : 2 : 80 ваг. ч. методом електролітичного анодування мають найкращі антивідбивні характеристики і менше оптичне пропускання.

Ключові слова: поруватий кремній, модифікація, фотоанодування, відбиття.

PACS number: 78.20. – e

# 1. ВСТУП

Наноструктуровані матеріали останнім часом викликають значний інтерес дослідників. Це пов'язано з нетиповістю їх властивостей в порівнянні з об'ємним матеріалом. Одним із таких матеріалів є поруватий кремній (ПК), який отримують зазвичай за допомогою електролітичного анодування [1]. При достатньо високій поруватості (≥ 50 %) він представляє собою систему взаємопов'язаних між собою кремнієвих нанокристалітів, поверхня яких відкрита для взаємодії з іншими молекулами [2]. Відомі роботи, у яких досліджується вплив сорбованих у пори поруватого кремнію молекул, що проявляють акцепторні властивості, на процеси безвипромінювальної рекомбінації. Зокрема, на молекули йоду [3],аміаку [2], діоксиду азоту та піридину [4], Br<sub>2</sub>, I<sub>2</sub>, KCl, KI [5]. Відзначимо, що дослідження адсорбції молекул галогенів у ПК важливо для розробки нових високочутливих газових сенсорів, сонячних елементів, оптичних і біомедичних застосувань.

Хоча на цей час властивості ПК достатньо висвітлені в літературі [6-12]. Дослідженню оптичних характеристик ПК присвячені роботи [7]. Але за умов модифікації поверхні ПК багато робіт висвітлюють лише структурні і електричні характеристики поверхні ПК [14-16]. Тому винятково важливим представляється з'ясування ролі модифікаторів-галогенів в дослідженнях оптичних властивостей одержаних шарів ПК.

## 2. МЕТА РОБОТИ

Дослідження оптичних властивостей шарів ПК модифікованих HCl I HBr за умов освітлення зразка і без нього.

# 3. ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

У роботі використовувалися пластини монокристалічного кремнію марки КДБ-4,5 з орієнтацією (100) р-типу товщиною 300 мкм. Концентрація легуючої домішки бору становила 1·10<sup>16</sup> см<sup>-3</sup>. Анодне травлення проводили при кімнатному освітленні зразка і при освітленні зразка лампою розжарування потужністю 500 Вт. Оцінка поруватості зразка вимірювалась гравіметричним методом. Зразки виготовлені в розчинах НF (48 %):H<sub>2</sub>O:HBr = 16:80:7 – 16:80:2 ваг. ч. і HF (48 %):H<sub>2</sub>O:HCl = 16:80:7 – 16:80:2 ваг. ч. в плині від 30 секунд до 30 хвилин при щільності струму 30 мкА/см<sup>2</sup>.

За допомогою однопроменевого спектрофотометра «Specord-80» були зареєстровані оптичні спектри відбиття в спектральному діапазоні 190-1100 нм. Прилад використовує джерело світла дейтерієву і галогенову лампи. Похибка вимірювання складає  $\pm$  20 %.

Оптичні спектри пропускання реєструвались за допомогою спектрофотометра типу СФ-46. Як зразковий фотодетектор використовували діод ФД-24К. На довжині хвилі  $\lambda = 0,9$  мкм монохроматична чутливість фотодіода складала 0,57 А/Вт. Середня квадратична погріппність виміру становила ± 5 %. Виміри проводили з кроком 10 нм. Виміри робили в режимі високого спектрального дозволу при розмірі вхідної щілини, рівної 0,25 мм. Похибка вимірювання довжини хвилі  $\lambda_i$  була не більше ± 1 %, а коефіціента відбиття – не більше ± 5 %.

Коефіцієнт заломлення розраховувався на основі спектрів пропускання або відбиття, отриманих в інфрачервоному і видимому діапазоні довжин хвиль [7]. Згідно з цією методикою були визначені попередні значення коефіцієнтів заломлення n':

$$n' = 1/(2d\Delta v)$$

де n' – коефіцієнт преломлення; d – товщина шару;  $\Delta v$  – різниця між хвильовими числами, що відповідають 2 сусіднім максимальним (max) або мінімальним (min) в спектрі.

Далі визначали номер інтерференційного піка:

$$m_{o,e} = [2dn'_{o,e}/\lambda]$$

де  $n = m\lambda/2d$  (для максимума);  $n = (m + 1/2)\lambda/2d$ (для мінімума); m – порядок інтерференційного максимума;  $\lambda$  – відповідна йому довжина хвилі.

Для використання в сонячних елементах у якості антивідбивного покриття необхідно провести аналіз оптичних характеристик шарів ПК, таких як спектри пропускання, відбиття і коефіцієнт заломлення ПК.

\* evgeniya-zubko@mail.ru

2077-6772/2012/4(2)02036(12)

#### 4. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Спектри пропускання у діапазоні довжин хвиль 600-1200 нм зразків ПК, що виготовлені в електролітах HF:H<sub>2</sub>O:HBr і HF:H<sub>2</sub>O:HCl зображені на рис. 1 і рис. 2 відповідно.



**Рис. 1** – Спектри пропускання ПК, виготовленого в розчині HF:H<sub>2</sub>O:HBr без фотоанодування (СК4, СК7, СК8, СК5) і з фотоанодуванням (БК8, БК6, БК1)

Отримано, що в результаті збільшення концентрації НВг в розчині в спектрах пропускання ПК спостерігається збільшення інтенсивності (рис. 1), що пов»язано зі знаходженням на поверхні молекул брому. Як видно з рис. 1 мінімальне значення пропускання (0,001 %) набуває при мінімальних значеннях концентрації НВг, яка становить 2 ваг.ч., і найбільшому часі травлення – 30 хвилин.



Рис. 2 – Спектри пропускання ПК, виготовленого в розчині HF:HCl:H<sub>2</sub>O без фотоанодування (ЧБК4, ЧБК3, ЧБК6) і з фотоанодуванням (ЧБК8, ЧБК9, ЧБК11, ЧБК12, ЧБК13)

Аналогічна тенденція спостерігається для зразків ПК, які виготовлені в електролітах HF:H<sub>2</sub>O:HCl (рис. 2). При найбільшому часі анодування (30 хв.) інтенсивність спектрів пропускання найменша, так як товщина шару ПК найбільша. Збільшення концентрації HCl незначно впливає на спектри пропускання.

Пластини з поверхневим опором 400-500 Ом мали стабільні піки пропускання 0,018 % у діапазоні 650-1000 нм.

Найбільше пропускання (0,02 %) мали зразки зі значною концентрацією дефектів  $10^9$  см<sup>-3</sup>, які представляли собою скупчення дефектів А-типу [16, 17] і мали вигляд спіралі в поперечному перетині монокристалічної пластини кремнію.

При розрахунках коефіцієнту заломлення зі спектрів пропускання отримано дані щодо залежності поруватості і коефіцієнту заломлення для зразків ПК за умов фотоанодування і без нього (рис. 3), які свідчать, що фотоанодування значно впливає на зміну властивостей ПК. Коефіцієнт заломлення і поруватість зразків, виготовлених в розчині HF:HCl:H<sub>2</sub>O за умов фотоанодування змінюється від 0,8 до 3,3 та 40-82 % відповідно; від 0,83 до 2,75 та в межах 42-86 % – для зразків, виготовлених в розчині HF:HBr:H<sub>2</sub>O; без фотоанодування - від 0,5 до 1,5 та в межах 32 – 66 % для зразків, виготовлених в розчині HF:HCl:H<sub>2</sub>O; від 0,7 до 0,98 та в межах 67-80 % для зразків, виготовлених в розчині HF:HBr:H<sub>2</sub>O.



Рис. 3 – Залежність коефіцієнта преломлення від поруватості: для зразків, виготовлених в розчині HF:HBr:H<sub>2</sub>O без фотоанодування (а), при фотоанодуванні (б); для зразків, виготовлених в розчині HF:HCl:H<sub>2</sub>O без фотоанодування (с), при фотоанодуванні (д)

Аналіз зразків за часом анодування дає наступний розподіл за коефіцієнтом заломлення і поруватістю (рис. 4). Коефіцієнт заломлення в межах 3,3-1,7 характерний для зразків, що виготовлені протягом 1 хвилини, в межах 1,5-0,8 – для зразків виготовлених протягом 10 хвилин, 0,7-0,55 – для зразків анодованих протягом 30 хвилин.



Рис. 4 – Залежність коефіцієнта заломлення від поруватості зразка, виготовленого в розчині HF:HCl:C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH:H<sub>2</sub>O при фотоанодуванні (назва залежностей є часом анодування зразка, кількість хвилин)

Експериментальні оптичні спектри відбиття для шліфованої поверхні монокристалічного кремнію (а), для зразків виготовлених в розчинах HF(48%):  $C_2H_5OH:H_2O = 16:4:80$  (е),  $HF(48\%):HCl:H_2O = 16:7:80$ (в),  $HF(48\%):HCl: H_2O = 16:2:80$  (г),  $HF(48\%):HBr:H_2O =$ 16:2:80 (д),  $HF(48\%):HBr:H_2O = 16:7:80$  (б) наведено на рис. 5. Особливості формування шарів модифікованих...



**Рис. 5** – Спектри відбиття для шліфованої поверхні монокристалічного кремнію (а), для зразків виготовлених в розчинах HF(48 %):C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH:H<sub>2</sub>O = 1,6:0,4:8,0 ваг. ч. (е), HF(48 %):HCl:H<sub>2</sub>O = 1,6:0,7:8,0 ваг. ч. (в), HF(48 %):HCl:H<sub>2</sub>O = 1,6:0,2:8,0 ваг. ч. (г), HF(48 %):HBr:H<sub>2</sub>O = 1,6:0,2:8,0 ваг. ч. (д), HF(48 %):HBr:H<sub>2</sub>O = 1,6:0,7:8,0 ваг. ч. (б)

Найкращі результати в усій області дослідження антивідбиттєвих втрат показали зразки виготовлені в розчині HF(48 %):HBr:H<sub>2</sub>O = 16:2:80 ваг. ч. При цьому слід зазначити, що в області  $\lambda \sim 650$  нм спостерігаються мінімальні втрати на відбиття.

Як відомо [11], ПК при контакті з повітрям може суттєво змінювати свої властивості. Тому для ефективного практичного використання у якості антивідбивного покриття сонячного елемента необхідно провести дослідження стабільності відбивних характеристик поверхні ПК в процесі старіння. На рис. 6 зображено спектри відбиття ПК через день після його формування, та через півроку перебування на повітрі.

Як видно з рис. 6 для характеристик зразка через півроку можна зазначити, що проявляються ті ж самі закономірності в спектральній залежності коефіціенту відбиття. Протягом часу спостерігається погіршення відбивних характеристик (~15 %) шарів ПК.



**Рис. 6** – Зміна антивідбиттевих характеристик під час старіння на повітрі: зразок через день після формування (б); зразок через півроку (а)

#### 5. ВИСНОВКИ

В ході проведення роботи визначено, що найменші антивідбиттєві характеристики і пропускання мали шари ПК, одержані в розчині HF(48 %):HBr:H<sub>2</sub>O = 16:2:80 ваг. ч.

Аналіз зразків за часом анодування дає розшарування на ділянки за коефіцієнтом преломлення. Перша ділянка коефіцієнта преломлення в межах 3,3-1,7 характерна для зразків, які були виготовлені в плині 1 хвилини, друга ділянка в межах 1,5-0,8 – для зразків виготовлених в плині 10 хвилин, третя ділянка (0,7-0,55) – для зразків анодованих в плині 30 хвилин.

При старінні зразка спостерігається погіршення відбиттєвих характеристик (~15%).

# Formation Features of the Porous Silicon Layers Modified by HCl and HBr in the Context of Optical Properties

# E.I. Zubko

## Zaporozhye State Engineering Academy, 22, Dobrolubova Str., Zaporozhye 69000, Ukraine

Transmission and reflection spectra, refraction factor of the porous silicon layers produced in HF(48%): HCl:H<sub>2</sub>O and HF(48%):HBr:H<sub>2</sub>O solutions are investigated by the sample illumination and without it. It is established that layers produced by electrolytic anodizing in HF(48%):HBr:H<sub>2</sub>O = 16:2:80 mass% solution have the best antireflective characteristics and smaller optical transmission than other samples.

Keywords: Porous silicon, Modification, Photoanodizing, Reflection.

## Особенности формирования слоев пористого кремния, модифицированного HCl и HBr, в контексте оптических свойств

#### Е.И. Зубко

Запорожская государственная инженерная академия, ул. Добролюбова, 22, Запорожье 69000, Украина

Исследованы спектры пропускания, отражения и коэффициент преломления слоев пористого кремния, изготовленного в растворах  $HF(48\%):HCl:H_2O$  и  $HF(48\%):HBr:H_2O$  при условиях освещения образца и без него. Установлено, что слои изготовленные в растворе  $HF(48\%):HBr:H_2O = 16:2:80$  мас.% методом электролитического анодирования имеют наилучшие антиотражательные характеристики и меньшее оптическое пропускание.

Ключевые слова: пористый кремний, модификация, фотоанодирование, отражение.

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- А.Н. Образцов, В.А. Караванский, Х. Окуши, X. Ватанабе, *ФТП* 32 No8, 1001 (1998) (А.N. Obraztsov, V.A. Karavanskii, H. Okushi, H. Watanabe, *Semiconductors* 32, 896 (1998)).
- А.В. Павликов, Л.А. Осминкина, И.А. Белогорохова, Е.А. Константинова, А.И. Ефимова, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров, *ФТП* **39** No11, 1385 (2005) (A.V. Pavlikov, L.A. Osminkina, I.A. Belogorokhov, E.A. Konstantinova, A.I. Efimova, V.Yu. Timoshenko, P.K. Kashkarov, *Semiconductors* **39**, 1338 (2005)).
- К.В. Захарченко, В.А. Караванский, Г.Е. Котковский, М.Б. Кузнецов, А.А. Чистяков, *Письма в ЖЭТФ* 73 No10, 578 (2001) (K.V. Zakharchenko, V.A. Karavanskii, G.E. Kotkovskii, M.B. Kuznetsov, A.A. Chistyakov, *JETP Lett.* 73, 510 (2001)).
- Е.А. Константинова, Ю.В. Рябчиков, Л.А. Осминкина, А.С. Воронцов, П.К. Кашкаров, *ФТП* 38 No11, 1386 (2004) (Е.А. Konstantinova, Yu.V. Ryabchikov, L.A. Osminkina, A.S. Vorontsov, P.K. Kashkarov, *Semiconductors* 38, 1344 (2004)).
- В.В. Болотов, Ю.А. Стенькин, Н.А. Давлеткильдеева, О.В. Кривозубов, И.В. Пономарева, *ФТП* **43** No1, 100 (2009) (V.V. Bolotov, Yu.A. Sten'kin, N.A. Davletkil'deev, O.V. Krivozubov, I.V. Ponomareva, *Semiconductors* **43**, 92 (2009)).
- Л.А. Головань, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров, УФН 177 No6, 619 (2007) (L.A. Golovan, V.Yu. Timoshenko, P.K. Kashkarov, Phys.-Usp. 50, 595 (2007)).
- 7. Л.А. Балагуров, В.Ф. Павлов, Е.А. Петрова, Г.П. Боронина,

*ΦΤΠ* **31** No8, 957 (1997) (L.A. Balagurov, V.F. Pavlov, E.A. Petrova, G.P. Boronina, *Semiconductors* **31**, 815 (1997)).

- А.Н. Образцов, В.Ю. Тимошенко, Х. Окуши, X. Ватанабе, ФТП 33 No3, 58 (1999) (А.N. Obraztsov, V.Yu. Timoshenko, H. Okushi, H. Watanabe, Semiconductors 33, 323 (1998)).
- М.П. Компан, И.Ю. Шабанов, *Письма в ЖЭТФ* 50 No10, 678 (1994) (М.Р. Котрап, I.Yu. Shabanov, *JETP Lett.* 50 No 10, 678 (1994)).
- Л.П. Кузнецова, А.И. Ефимова, Л.А. Осминкина, Л.А. Головань, В.Ю. Тимошенко, П.К. Кашкаров, *ФТТ* 44 No5, 780 (2002) (L.P. Kuznetsova, A.I. Efimova, L.A. Osminkina, L.A. Golovan', V.Yu. Timoshenko, P.K. Kashkarov, *Phys. Solid State* 44, 811 (2002)).
- 11. М.М. Мельниченко, Вісник КУ. С.: ФМН 2, 247 (2009).
- А.И. Белогорохов, Л.И. Белогорохова ФТП 33 No2, 198 (1999).
- L. Remache, A. Mahdjoub, E. Fourmond, J. Dupuis, M. Lemiti, *International Conference on Renewable Energies* and Power Quality (ICREPQ'10) Granada (Spain), (2010).
- A. Ramizy, J. Aziz, Z. Hassan, K. Ibrahim, *Microelectron*ics International 27 No2, 117 (2010).
- S.A. Boden, D.M. Bagnall, *Prog. Photovolt: Res. Appl.* 17 241 (2009).
- С.Я. Швець, Ю.В. Головко, С.І. Зубко, Теория и практика металлургии 80-81 No3-4, 90 (2011).
- 17. С.І. Зубко, К.Л. Дикий, Металургія 23, 128 (2011).